

Title (en)

Process for cleaning by plasma an object

Title (de)

Verfahren zur Plasmareinigung eines Bauteils

Title (fr)

Procédé pour le nettoyage par plasma d'une pièce

Publication

EP 1570921 A1 20050907 (DE)

Application

EP 04004892 A 20040302

Priority

EP 04004892 A 20040302

Abstract (en)

The method involves observing specific parameters of the plasma whereby a crack (4) which emanates from the surface (22) of the component is cleaned through the plasma (7) based on the variation of at least one of the parameters. The component part can be arranged in a chamber (13) with an electrode (10) for initiating a plasma whereby a constant pressure prevails and a distance of the electrode from the surface of the component is varied in dependence on the depth of the crack.

Abstract (de)

Risse nach dem Stand der Technik lassen sich nur schwierig reinigen und führen oft zu einer Schädigung anderer Bereiche des zu reinigenden Bauteils. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird ein Plasmareinigungsverfahren angewendet, in dem ein Druck (p) und/oder ein Abstand (d) einer Elektrode (10) zu dem Bauteil (1) variiert wird, um ein Plasmareinigung in dem Riss (4) zu erzielen. <IMAGE>

IPC 1-7

B08B 7/00

IPC 8 full level

B08B 7/00 (2006.01); **C23G 5/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)

B08B 7/00 (2013.01 - EP US); **C23G 5/00** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [Y] EP 0313855 A2 19890503 - IBM [US]
- [Y] EP 0740989 A2 19961106 - BRIDGESTONE CORP [JP]
- [A] EP 1135540 B
- [A] US 4098450 A 19780704 - KELLER DONALD L, et al
- [A] FR 2836157 A1 20030822 - USINOR [FR]

Cited by

DE102008019892A1; EP2189627A1; FR2994538A1; RU2637598C2; US9126361B2; US10006305B2; WO2014027157A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)

EP 1570921 A1 20050907; CN 100586586 C 20100203; CN 1946489 A 20070411; DE 502005007139 D1 20090604; EP 1722901 A1 20061122; EP 1722901 B1 20090422; US 2007215174 A1 20070920; US 7513955 B2 20090407; WO 2005084830 A1 20050915

DOCDB simple family (application)

EP 04004892 A 20040302; CN 200580006606 A 20050209; DE 502005007139 T 20050209; EP 05701389 A 20050209; EP 2005001301 W 20050209; US 59151205 A 20050209